PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-022050

(43) Date of publication of application: 04.02.1984

(51)Int.CI.

G03F 1/02 H01L 21/30

(21)Application number : **57-131830**

(71)Applicant: VICTOR CO OF JAPAN LTD

(22) Date of filing:

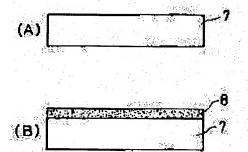
28.07.1982

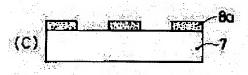
(72)Inventor: MACHIDA KOZO

(54) PHOTOMASK

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a photomask capable of forming a high precision pattern free from chromium defects, by forming a specified resist film for intercepting photoetching light on the surface of a glass substrate. CONSTITUTION: A compsn. for intercepting photoetching light is obtained by mixing 2W3wt% material, such as Congo red, for intercepting a photoetching light, such as UV rays, with a polymer compd. sensitive to electron beams, such as polymethyl methacrylate. The surface of the glass substrate 7 is coated with said compsn. to form a resist film 8 having a thickness absorbing ≥95% of UV rays. This film 8 is irradiated patternwise with electron beams, and subjected to developing, water washing, hardening, and





drying to form a resist film 8a having a UV rays intercepting region. As a result, the pattern edges of the resist film can be sharply formed.

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特.許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭59-22050

f) Int. Cl.³
 G 03 F 1/02
 H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 J 7447-2H Z 6603-5F ⑬公開 昭和59年(1984)2月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

砂ホトマスク

②特

願 昭57-131830

②出 願 昭57(1982)7月28日

⑩発 明 者 町田光三

川崎市神奈川区守屋町3丁目12

番地日本ビクター株式会社内

⑪出 願 人 日本ビクター株式会社

横浜市神奈川区守屋町3丁目12

番地

砂代 理 人 弁理士 伊東忠彦

数 脚 现

1. 発明の名称

ホトマスク

2. 特許請求の範囲

ガラス基板の表面に、光蝕刻用の光を透過しない 材料を混入或いは該材料にて染色され、電子 ビーム或いは紫外級光にて描画された光蝕刻用光阻止 レジスト 膜を設けてなることを特徴とするホトマスク。

3. 発明の詳細な説明

本発明はホトマスクに係り、レジスト膜に光蝕
刻用光を透過しない材料を用い、少ない工程で安
価に構成でき、しかもクロム欠け等のない高精度
のパターンを得ることのできるホトマスクを提供
することを目的とする。

I C 基板 取いは 金属 板等を 光 触刻 (ホトリングラフイ) によつて 所定 パターン に 敬 細 加 工 する 場合、 ブロキシミテイタイプ 取い は 縮 小 投 影 タイプ の 加 工 で は 被 加 工 物 の 上 方 に 所 定 パ ターン の 光 阻 止 領 域 を 設け られた ホトマスク を 被 加 工 物 と 雕 間

して設置し、ホトマスクの上方より紫外線光をホトマスクを介して被加工物に照射して被加工物の所定部分を光蝕刻して所定パターンを得る。このような光蝕刻に用いるホトマスクには銀塩粒子を含むゼラチン乳剤を光阻止領域に用いたエマルジョンタイプのものと、クロム膜を光阻止領域に用いたハードマスクタイプのものの2種類が多用されている。

特開昭59-22050(2)

結像特性からみても厚すぎ、シャーブなパターンを得にくく、又、転写を行ないにくい欠点があつた。更に、このものは後述のハードマスクタイプのものに比して柔らかく、損傷し易い等の欠点があつた。

このものは、製造工程が多く複雑であるために

実施例の製造工程を説明する既略図を示す。その 製造に際し、同図Wに示すガラス基板7(エマル ジョンタイプ又はハードマスクタイプのいずれの ものに用いられるガラス姦板であつてもよい)の 表面に、同図的に示す如く、電子ヒームに感光す る例えばポリメチルメタアクリレート (PMMA)、 OEBR (商品名)、ゼラチン等のレジスト膜 8 を スピンコート或いはスプレーコートによつてコー トする。レジスト膜8には予め紫外線光をカット (赤色又は黄色の波長以下を吸収)する染料(例 えばコンゴーレッド、ダイヤシジンレッドH(い ずれも商品名)或いはフタロシアニン系の染料) が混合されている。との場合、レジスト膜8の膜 厚は、染料の濃度により異なるが紫外線光を95% 以上吸収するよりな値に設定する。これはレジス ト膜8の薫簾の28~38の染料を混入すること により得られる。

次に、一般の電子ビーム描画と同様に、レジスト膜 8 に電子ビームによつて所定パターンを描くと、同図(C)に示す如く、所定パターンに応じた部

安価に構成し得ず、又、クロム膜5成膜時に生じ るピンホールやとの時に混入する風埃等によつて 所調クロム欠けを生じ易く、义、レジスト展 6 成 膜時に視入する幽埃によつて所謂クロム残りを生 し易く、更に、クロム膜を用いているため、カラ ス基板内に含まれるナトリウムイオンとクロムと の化合によつて所謂マウスニップルと称するクロ ム欠けを生じる等の欠点があり、又、歩留り率が **悪く、この点からも安価に構成し得ない欠点があ** つた。更に、このものは、所定パターン形成前の 所聞プランクマスクの状態で8千円(ガラス転板 として5インチの背板ガラスを用いた場合)乃至 2 万円(ガラス基板として 5 インチの石英ガラス を用いた場合)であり、エマルジョンタイプの千 円(ガラス基板として5インチの白板ガラスを用 いた場合)に比して8倍乃至20倍もし、この点 からも安価に構成し得ない欠点があつた。

本発明は上配欠点を除去したものであり、 第3 図以下と共にその各契施例について説明する。

第3図W~Oは本発明になるホトマスクの第1

分にレジスト腺8aが残る。しかる後、これを現 像、洗浄、硬化乾燥すると目的のホトマスクが完 成する。このものはレジスト腺8a中に紫外線光 をカットする染料が混合されているので、レジス ト膜8aそのものを紫外線光阻止領域として用い 徘る。

なお、本実施例のものはクロム膜を用いず、レジスト 脚等の高分子材料を用いているのでハード

特開昭59-22050(3)

マスクタイプのものより強靱性は劣る。然るに、 競近光触刻加工に多用されているプロキンミテイ タイプ又は稲小投影タイプは被加工物とホトマス クとを値かに腱間させて加工するので、ホトマス クにはそれ程の強靱性は必要でなく、ハードマス クタイプのものに比して強靱性が劣つていても特 に間題はない。

r

明4回(A)~砂は本発明になるホトマスクの第2 実施例の製造工程を散明するための破略図を示す。 第3回(A)~(C)に示す第1実施例のものはレジスト 般8に架外級光をカットする染料を混合されているので所定パターンを描画する手段として架外級 を用い得ない。そこで、第4回(A)~回に示す第2 実施例のものでは所定パターン形成後にレジスト とに染料を染色するようにし、パターン形成に 子ピームでも紫外級光でも両方用い得るようにし たものである。

その製造に際し、回図のに示すガラス基板 9 の 装面に、同図的に示す如く、重クロム酸カリ又は 重クロム酸アンモンを 1 ~ 2 准量多於加されたセ

同図より明らかな如く、染色されたレジスト膜 10a'を有する部分は紫外線光を完全にカットし得る。

なか、上記レジスト與 8 , 1 0 は上記材料の他、ポリウレダン系、ポリカーポネート系、ケイ酸エステル系等の高分子樹脂取いはゴム系レジスト等でもよい。

又、レジスト膜8a,10a'は染料の他、顔料を 混合、或いは顔料にて染色されたものでもよい。

又、レンスト膜と染料(又は顔料)との組合わせにより光透過率が異なるため、 散通の光透過率が得られ、かつ、混合性の坂もよい組合わせを適 宜選定すればよい。

又、レジスト膜の材料としては、切断されている分子間が電子ビームによつて架橋されるネガ形、及び架橋されている分子間が電子ビームによつて 切断されるポジ形に分けられるが、本実施例では いずれのものも適用し得る。

又、電子ビームによるパターン描画では電子によりレジスト膜が帯電して精密なパターンを描画 できなくなることがあるが、この場合、例えば銀 ラチンのレジスト膜10を例えば14mの膜厚に成膜する。このレジスト膜10は電子ビームにも感応し、紫外般光にも感光する。しかる後、レジスト膜10に電子ビーム或いは紫外線光を照射して 所定パターンを描くと同図(C)に示す如く、所定パターンを描くと同図(C)に示す如く、所定パターンを描くと同図(C)に示すない。しかる後、これを現像、洗浄する。

次に、问図(C)に示すマスク11を数個用意しておき、これを问図(D)に示す如く、例えばスミノールレッド、カヤノールレッド(いずれも商品名)等の赤色系の酸性染料 0.4分合 ひ染色 被12中に例えば2分間役し、レジスト膜10aを染色する。しかる後マスク11を被12から取出すと、问図(C)に示す如く、被12にて染色されたレジスト膜10a'を有するマスクが完成する。

第 5 図に、膜厚 1μm のレジスト膜 10a を機度 0.4%、 温度 6 0 ℃の上記染色 板 1 2 中に 2 分間 役した場合のレジスト膜 10a'の 紫外光透過率対波 長特性図 を示す。 同図中、 ラインとは 水銀灯 h - lineによ つて 得られる 40 4.7 nmの 紫外線光を示す ラインで、

化インジウムや酸化パナジウム等の透明の導電性 膜をガラス基板とレジスト膜との間に介押したり、 或いはこれをレジスト膜の要面にコートすること により電子の帯電を防止できる。このよう左導電 性膜はパターン描画と同時或いはパターン描画後 にエッチング等により容易に除去できる。又、電 でエッチング等により容易に除去できる。又、電子帯電の他の防止方法として、レジスト膜そのも のに導電性を特つものを用いてもよい。

価に構成し得、又、クロム腺を用いる必要がないので、ピンホールによるクロム欠けやマウスニップルを生じることはなく、ハードマスクタイプに比して高精度のバターンを得ることができる等の特長を有する。

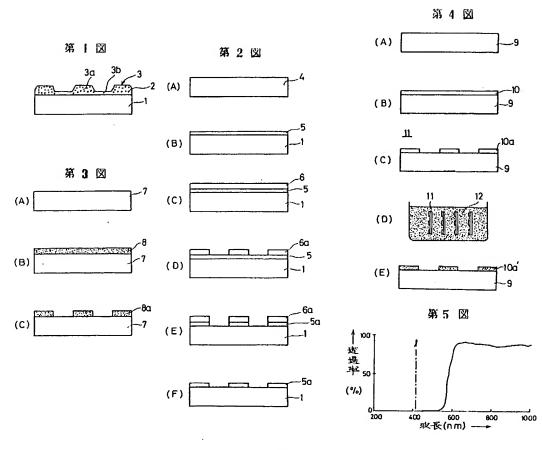
4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来のエマルションタイプのホトマスクの一例の 概略正面図、第2 図 W ~ (4) は従来のハードマスクタイプの一例の製造工程を説明する 観略図、第3 図 W ~ (4) は本発明ホトマスクの第1 実施例の製造工程を説明する 観略図、第4 図 W ~ (4) は本発明ホトマスクの第2 実施例の製造工程を説明する 観略図、第5 図 は本発明ホトマスクの第2 実施例におけるレジスト膜の波長対透過率特性図である。

7 , 9 … ガラス 務板、 8 , 8 a , 1 0 , 10a , 10a'… レジスト膜、 1 1 … ホトマスク、 1 2 … 染色液。

特許出願人 日本ピクター株式会社代 理 人 弁理士 伊 東 忠 彦





-310-